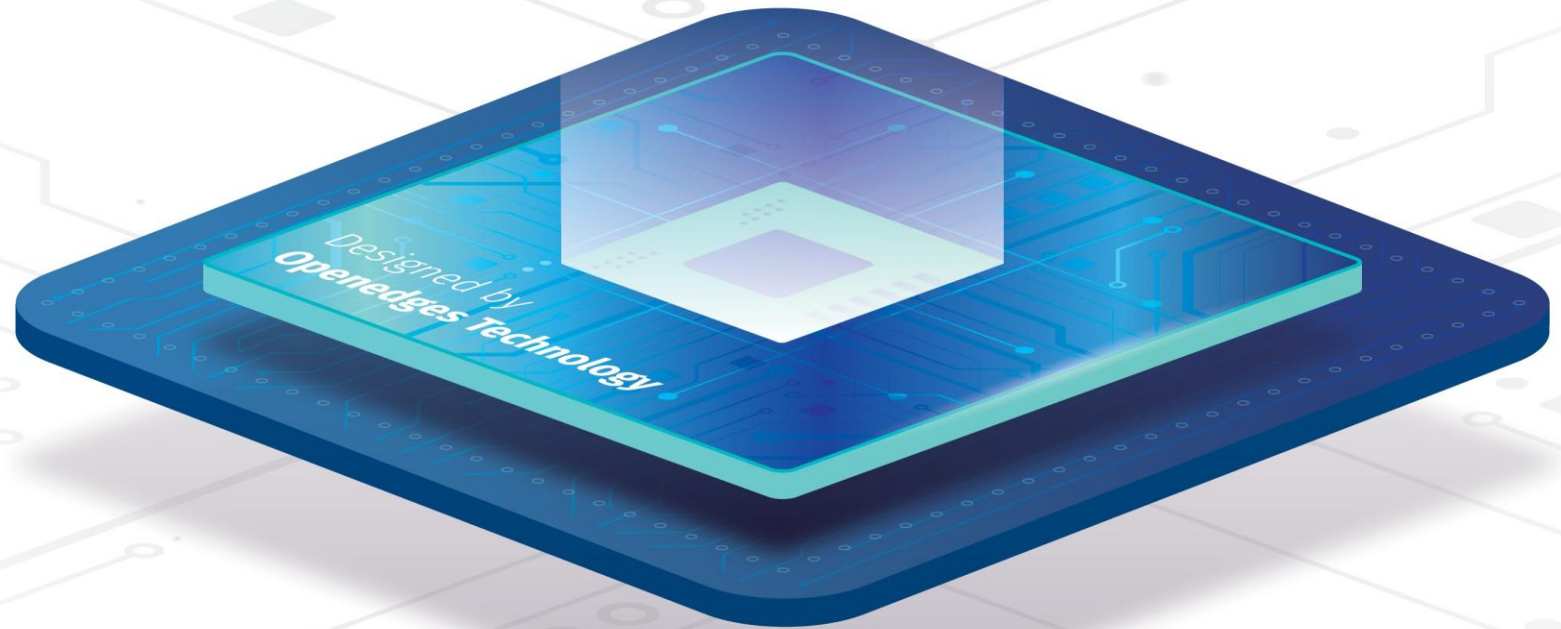


AI for Everyone, Everywhere



Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 오픈엣지테크놀로지 주식회사 (이하 "회사")에 의해 작성됐으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

The Future of AI Computing

Table of Contents

Openedges
Technology
at a Glance

Prologue

01
시스템 반도체 시장의
구조적 성장

02
국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업,
오픈엠티테크놀로지

03
2026년
Investment
Highlights

04
2025년 3분기
경영실적

Appendix

Openedges Technology at a Glance

33%

연매출 성장률(최근 5년)

* '21년~'25년



71

누적 라이선스 계약

* '25년말 기준



149

Global R&D Engineers

* 전체 인력(170명)중 88%
(한국 최대규모)



AI for Everyone, Everywhere

OPENEDGES

30+

고객사 수

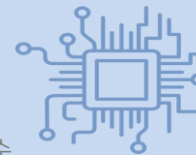
* 삼성전자, SK Hynix, Micron 등
글로벌 Top-tier 고객 기 확보



20+

판매가능 IP 제품 수

* IP 종류는 총 4종이며
각 제품군 내 판매가능 개별 IP 제품 수



3

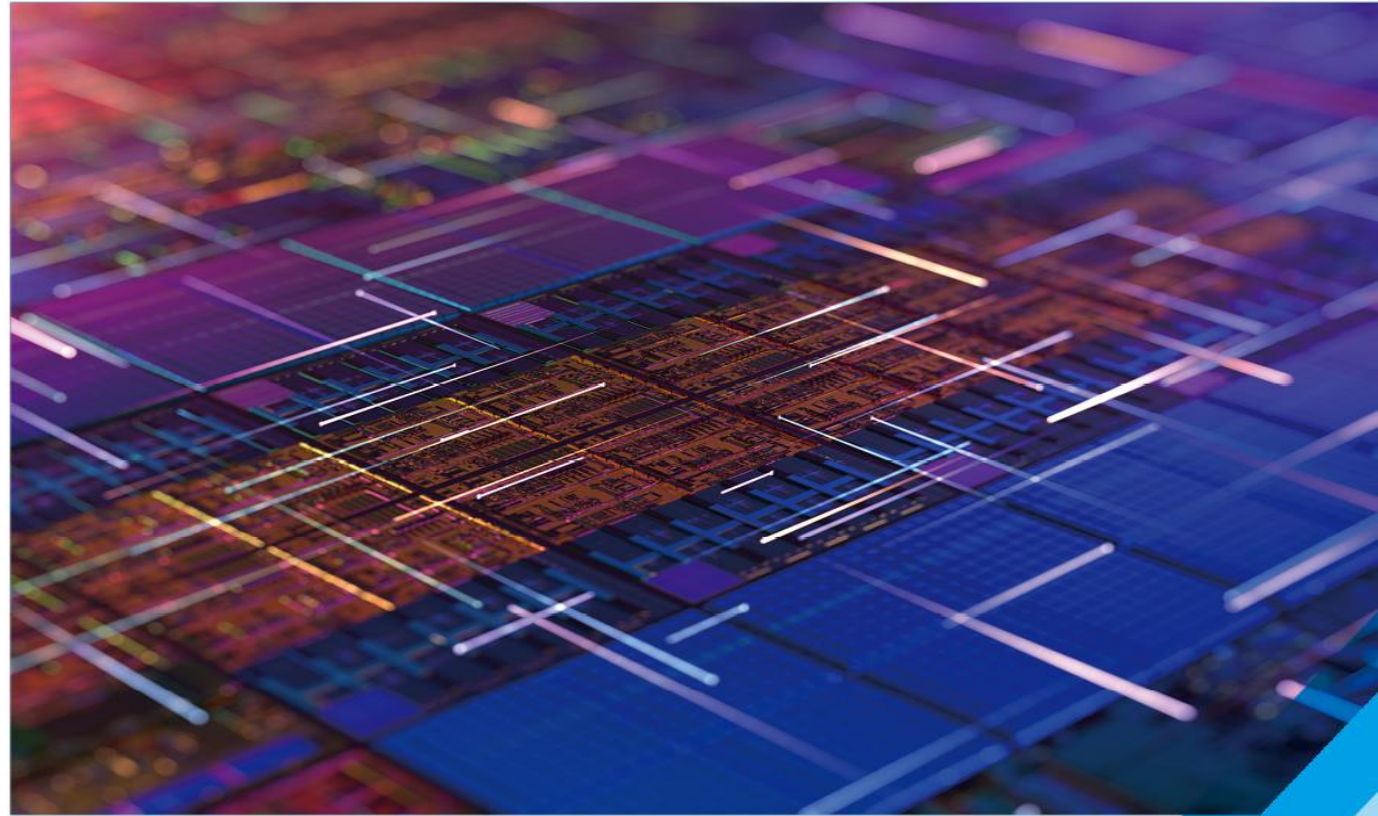
글로벌 R&D 센터

* 한국, 캐나다, 일본 소재



Prologue

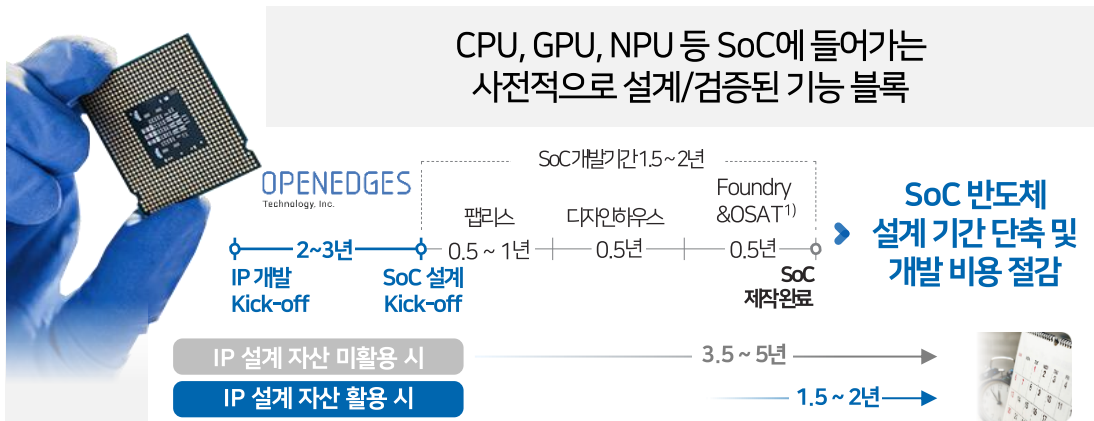
오픈엣지테크놀로지 사업 영역



오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ①

반도체 IP는 AI 반도체를 포함한 SoC (System on Chip)의 개발 기간 단축과 비용 절감 및 천억 원 이상 규모의 개발 실패의 위험을 경감시키는 높은 수준의 기술력이 요구되는 Ready-made 솔루션

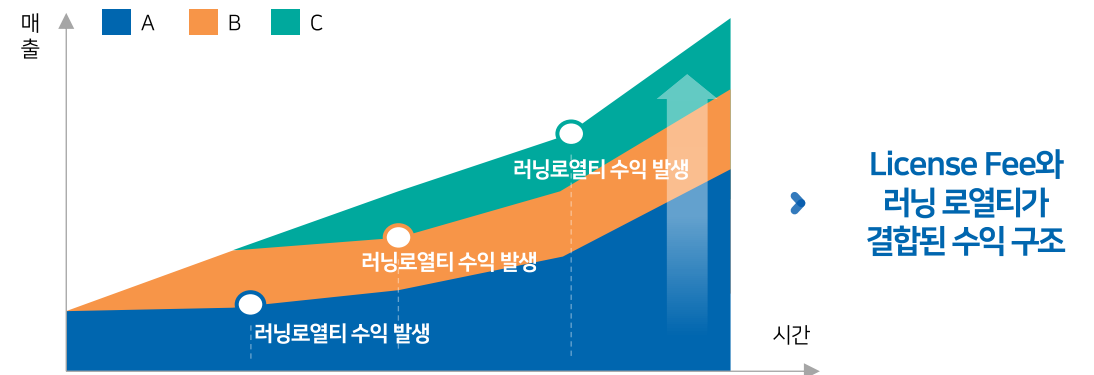
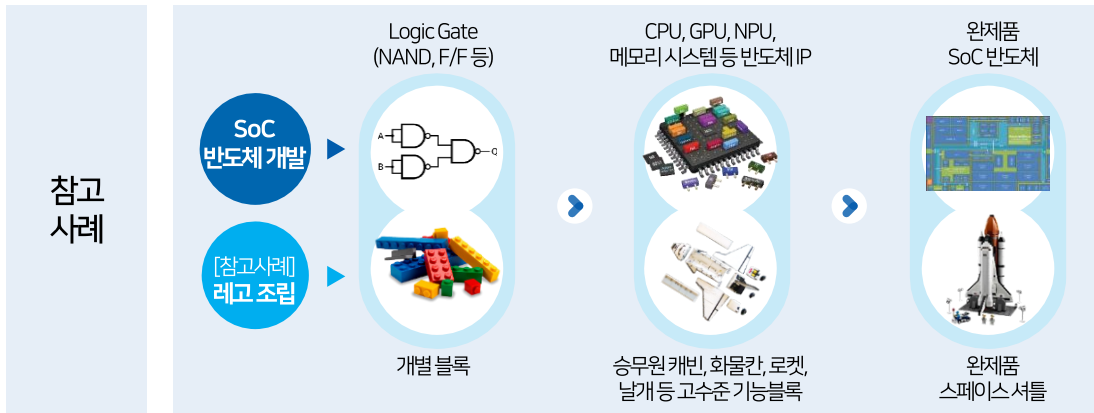
반도체 IP란?



반도체 IP 사업의 수익 구조



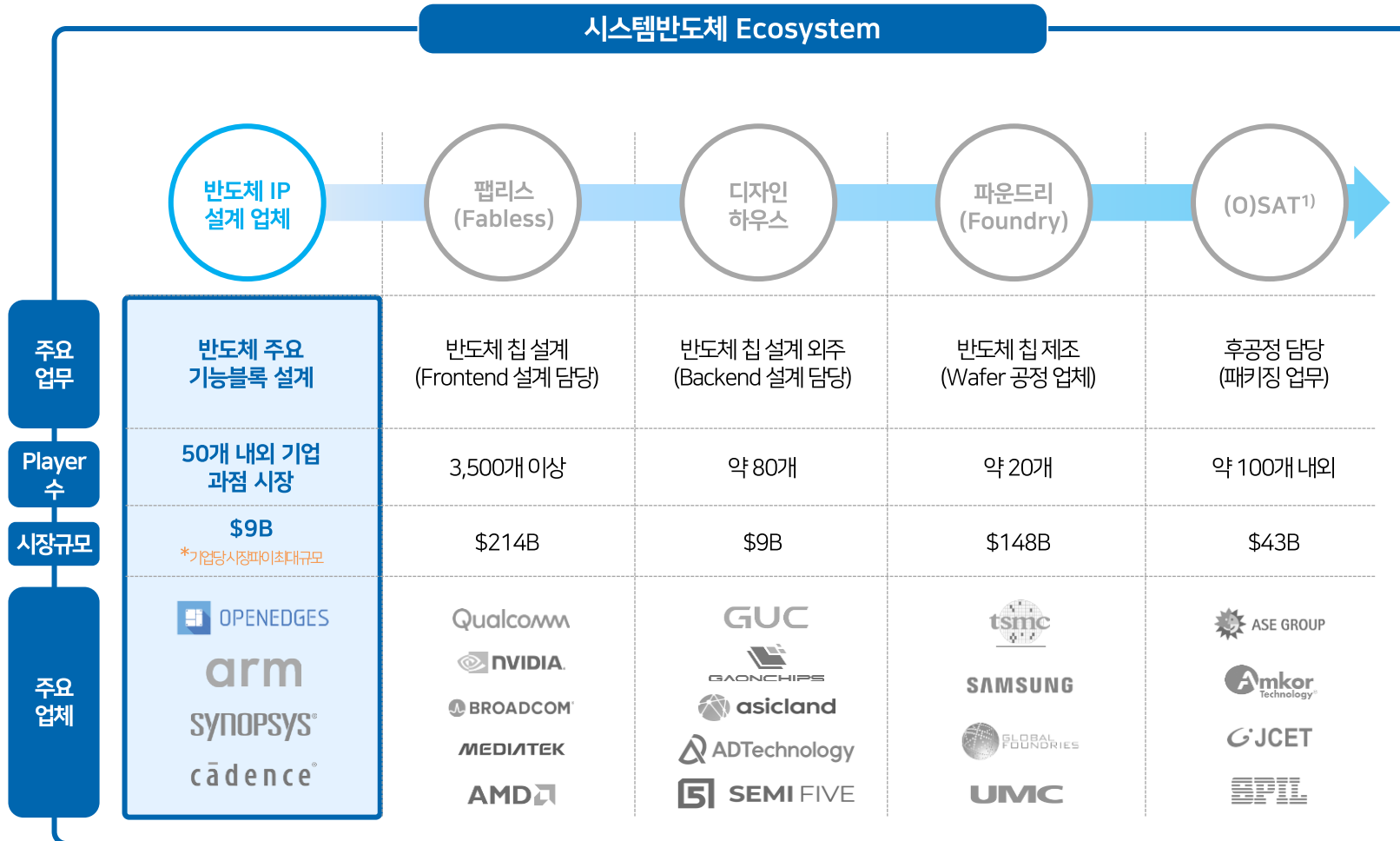
※ 반도체 IP 업계는 높은 기술장벽으로 소수 플레이어의 과점시장



* 주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test (패키징 등 후공정 업체)

오픈엠티테크놀로지 사업 영역 ②

반도체 IP 기업은 팹리스 및 디자인하우스가 필요로 하는 기능 블록을 선제적 개발 및 공급



IP시장의 과점화 이유

검증된 IP에 대한 니즈 증가



진입장벽이 높아
검증된 IP 업체의
희소 가치 부각



고도의
기술 인력
필요

최소 3년
이상의 R&D
투자 필요

* 주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test: 반도체 패키지 조립 및 테스트 업체로 웨이퍼 공정 이후 후공정 담당

오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ③

AI 반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 설계 및 제공



AI 반도체

인공지능 학습과 실행에 최적화된 신경망 처리장치

① NPU

스케줄링 알고리즘에 따라 SoC와 DRAM 간 고속 데이터 통신을 제어

③ Memory Controller

MEMORY CONTROLLER

④ PHY

SoC와 DRAM 간 고속 데이터 전송

PHY

② On Chip Interconnect

SoC 내 데이터 이동 통로

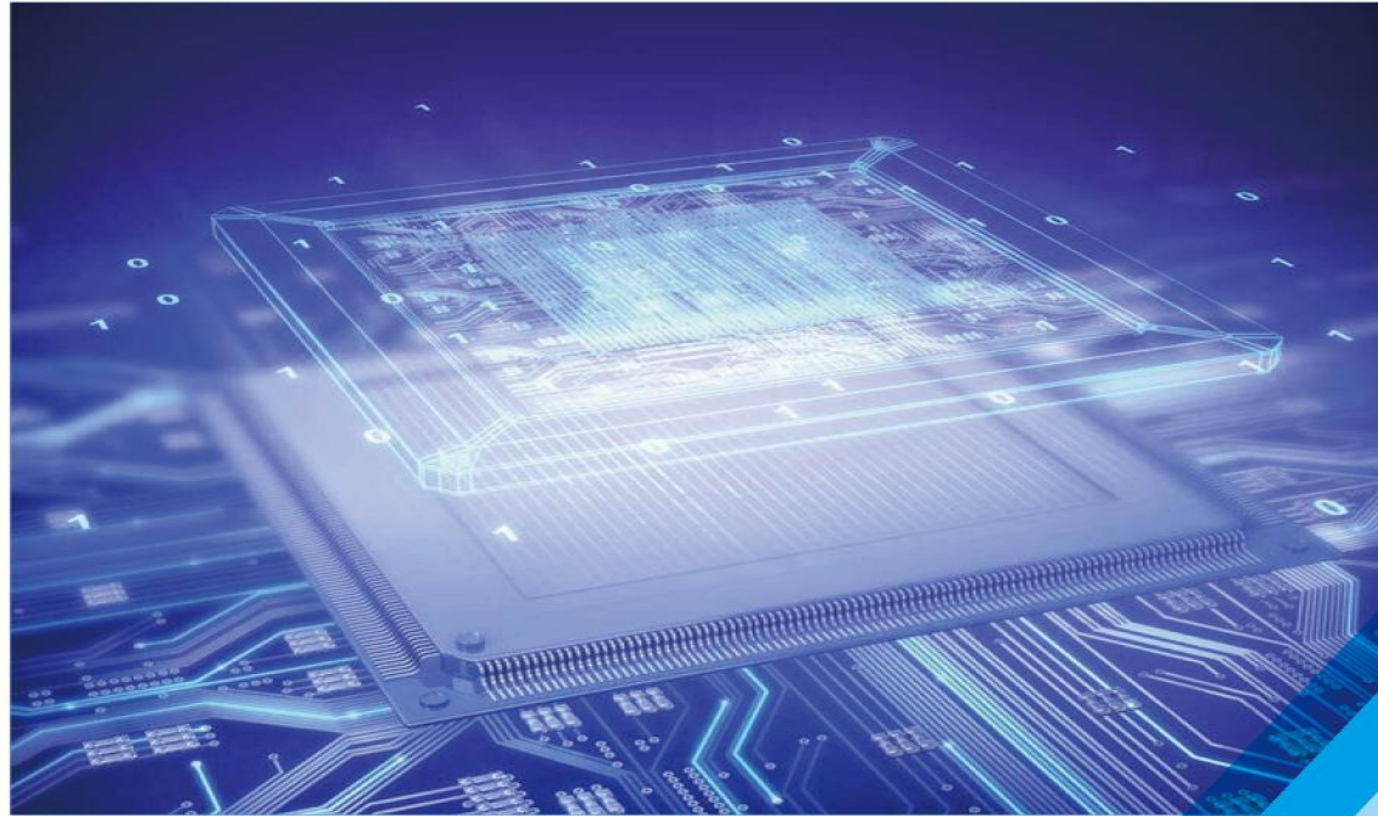
ONCHIP INTERCONNECT

DDR DRAM

01

시스템 반도체 시장의 구조적 성장

- 01. 반도체 및 IP 시장 성장
- 02. 당사 주력 LPDDR 시장 성장

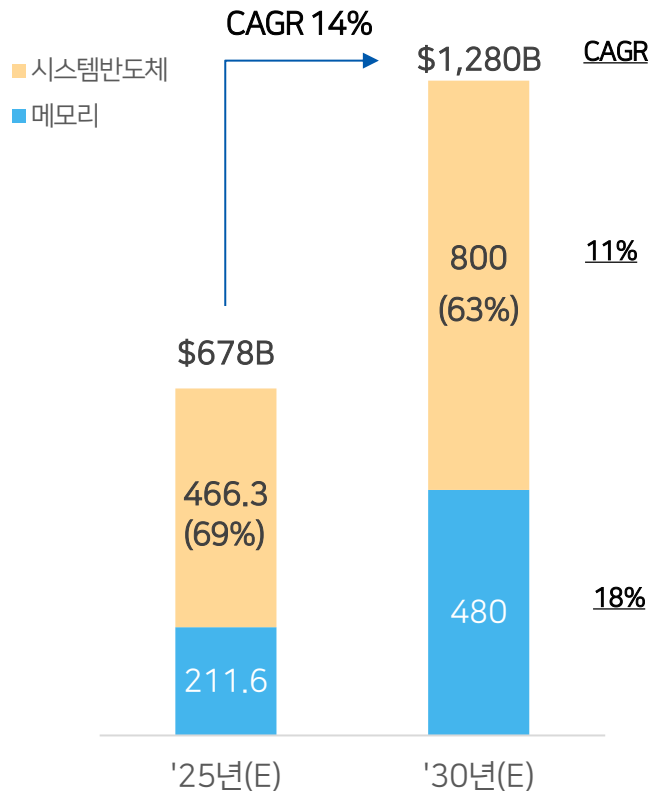


01 | 반도체 및 IP 시장 성장

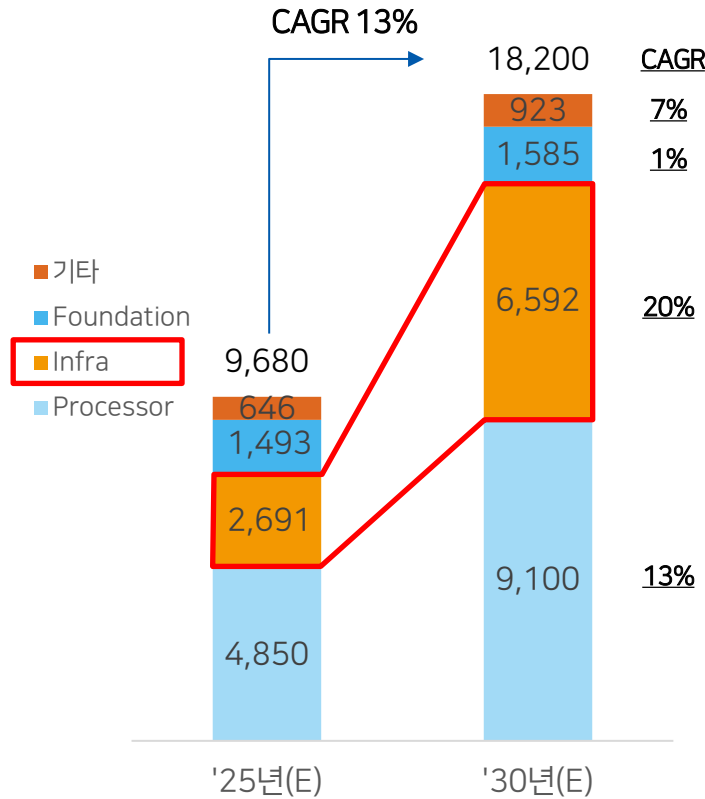
고성능 AI 반도체의 Data 병목 해소를 위해 고속 Infra IP 시장 규모 및 시장 내 비중이 지속 확대될 전망

* Interface 및 Interconnect IP

반도체 시장

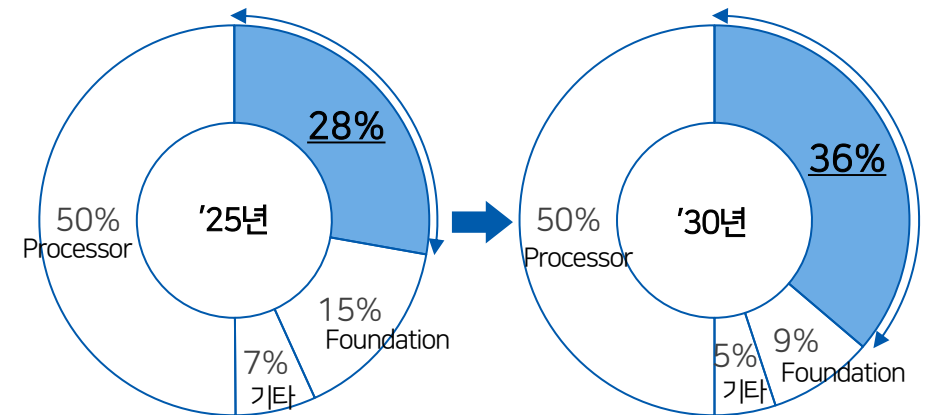


반도체 IP 시장



당사 IP 시장 Coverage

“고성능 반도체 칩 성능 구현에 핵심적인 역할을 담당하는 고속 Infra IP Needs 증가로, 당사가 참여 중인 IP 시장 비중이 36%까지 확대”

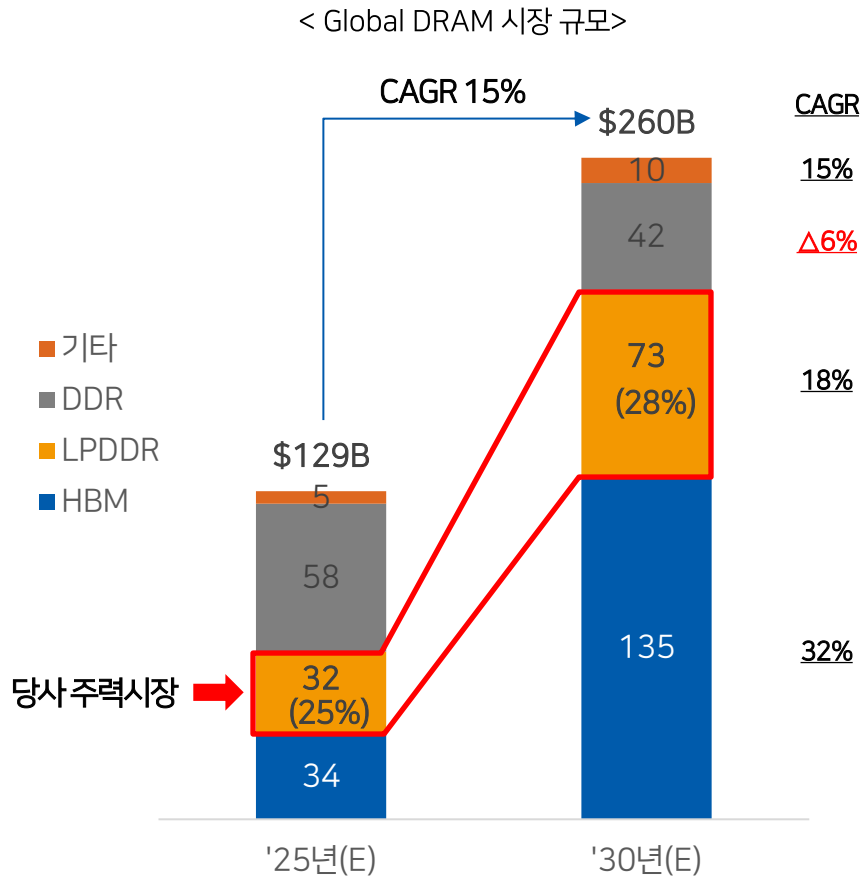


※ NPU IP 시장은 Processor에 포함되며, 비중은 '30년 3% 내외로 추정

※ Source: WSTS('25.12월), IPnest ('25.04월) 등 주요 시장 조사기관 추정치 종합

02 | 당사 주력 LPDDR 시장 성장

On-Device AI 확산으로 LPDDR 메모리 수요는 연평균 18%의 견고한 성장 전망
 → 당사 주력 LPDDR IP 라이선스 기회 확대



• 서버용은 HBM, Edge Device용은 LPDDR로 양분되는 Market Trend가 심화될 전망

- 단, 서버용 HBM은 소수의 대규모 팹리스 수요가 대부분으로 IP 라이선싱 기회 제한적

• LPDDR 수요처가 서버용으로도 확대 중

- 전성비 및 가성비가 중요한 추론용 AI 서버 시장에서의 수요 증가
- Microsoft는 신규 데이터센터에 LPDDR5X를 도입 ('26.1월)

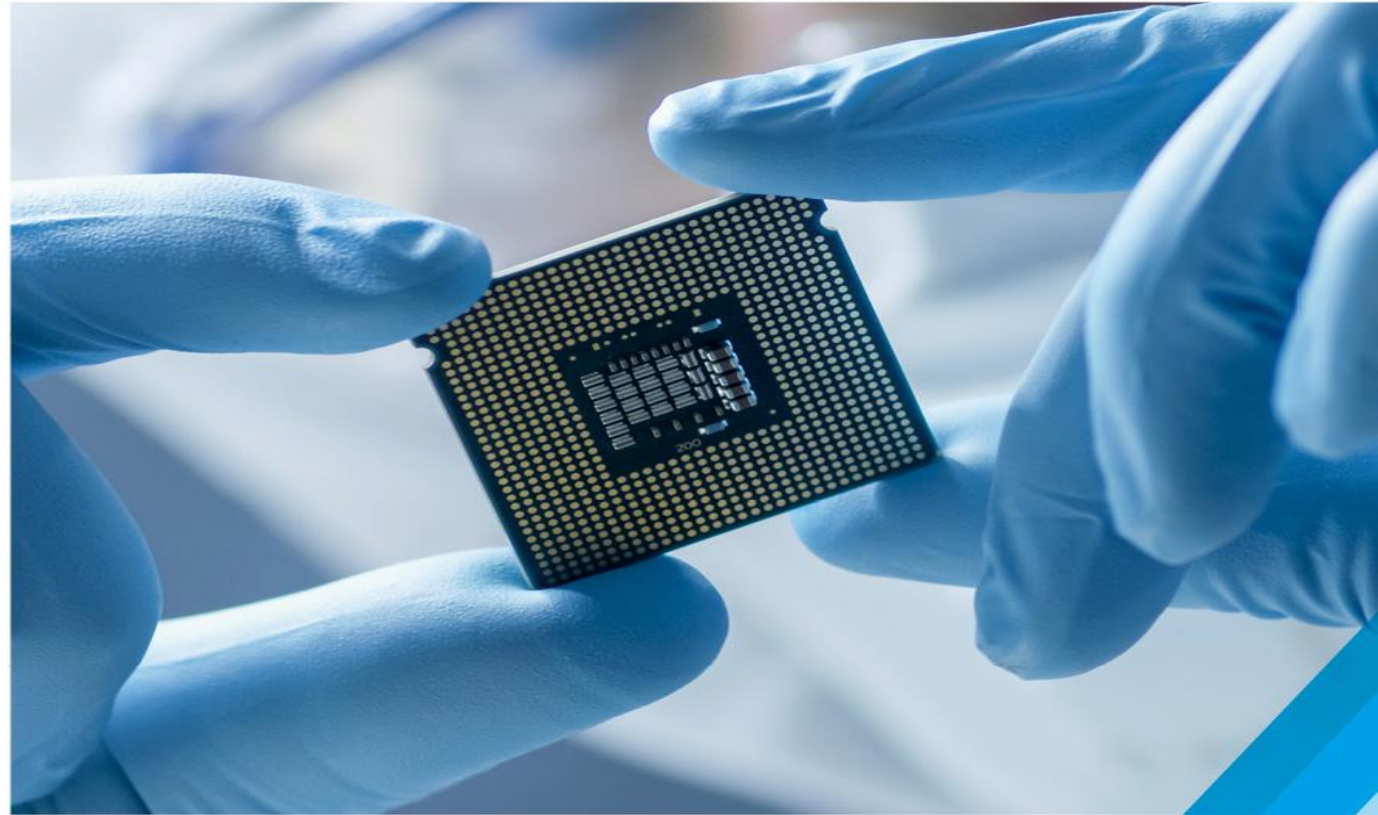
Key Feature	Market Needs
Low Power (저전력)	<ul style="list-style-type: none"> • 전력 소비 절감: 모바일 및 온디바이스 AI 기기의 배터리 수명 극대화 • 발열 관리 최적화: 고밀도 서버 환경에서 냉각 비용 및 TCO 절감
High Bandwidth (고대역폭)	<ul style="list-style-type: none"> • 데이터 병목 해소: LPDDR6 기반 최대 14.4Gbps로 향상된 전송 속도(LP5: 6.4Gbps) • 실시간 처리: LLM 등 대규모 파라미터 추론 시 지연 시간(Latency) 최소화

※ Source: Yole Group(2025.06), Gartner(2026.01), TrendForce(2025.Q4) 등 주요 시장 조사기관 추정치 종합

02

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엠티테크놀로지

01. 오픈엠티테크놀로지 핵심경쟁력 Summary
02. 글로벌 최고 수준의 Manpower
03. 업계 최고 수준의 기술경쟁력
04. 검증된 글로벌 Track Record
05. 글로벌 기업과의 전략적 Partnership



01 | 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary

오픈엣지는 AI 반도체 IP 시장의 글로벌 리더가 되기 위한
핵심 성공요인을 확보



02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower - Global Presence

한국 외 캐나다, 일본 소재 글로벌 R&D 거점 운영 중 (총 임직원 수 170명)

주요 역할	IP R&D 및 Sales
설립 시기	'17년 12월
임직원 수	총 121명*



* '25년말 기준

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower

국내 최대 규모 및 Global 경쟁력을 갖춘 R&D Engineer들이 확보된 반도체 IP 설계기업



전사 R&D 인력현황

총인원(170명)의

88%



149명
R&D 인력

R&D 인력중
석박사(66명) 비중

44%

석사



박사

지역별 현황



한국 137명



캐나다 27명



일본 6명

* '25년말 기준



이성현
대표이사/CEO

SAMSUNG | SAMSUNG ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

서울대학교 전기·컴퓨터공학 박사 수료
'17~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) 대표이사
'08~'15 삼성전자 수석연구원 (Exynos 개발)
'07~'08 삼성종합기술원



최정환
NPU 팀장

SK hynix | SAMSUNG

Purdue대학교 전기 및 컴퓨터공학 박사
'18~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) NPU팀장
'15~'18 SK 하이닉스 수석연구원
'09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장



김대우
Verification 팀장

MIDAS | SAMSUNG

서울대학교 건축학 석사
'22~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) Verification팀장
'05~'22 삼성전자 Digital Technology팀 파트장
'01~'05 MIDAS IT



Richard Fung
TSS/CEO

AMD | PERASO

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~ 現 The Six Semiconductor CEO
'12~'18 Peraso Technologies Silicon Director 등
'00~'11 AMD PHY Analog Design Manager



문상훈
VP/MC팀장

SK hynix | SAMSUNG

서울대학교 컴퓨터공학 석사
'18~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) MC팀장
'17~'18 SK 하이닉스 Memory System연구소 파트장
'00~'16 삼성전자 AP개발팀 파트장



김수호
PHY 팀장

SK hynix | SAMSUNG

성균관대학교 전기공학 석사
'21~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) PHY팀장
'18~'21 SK 하이닉스 NAND IP 개발팀장
'98~'17 삼성전자 수석연구원



Takashi Yamada
OTJ/Reginal VP

socionext | Panasonic

University of Tokyo Denki, 전기공학 학사
'24~ 現 오픈엠티테크놀로지 일본법인 Regional VP
'15~'24 SOCIONEXT Inc., Principal Engineer
'88~'15 PANASONIC Corporation



Ricky Lau
TSS/CTO

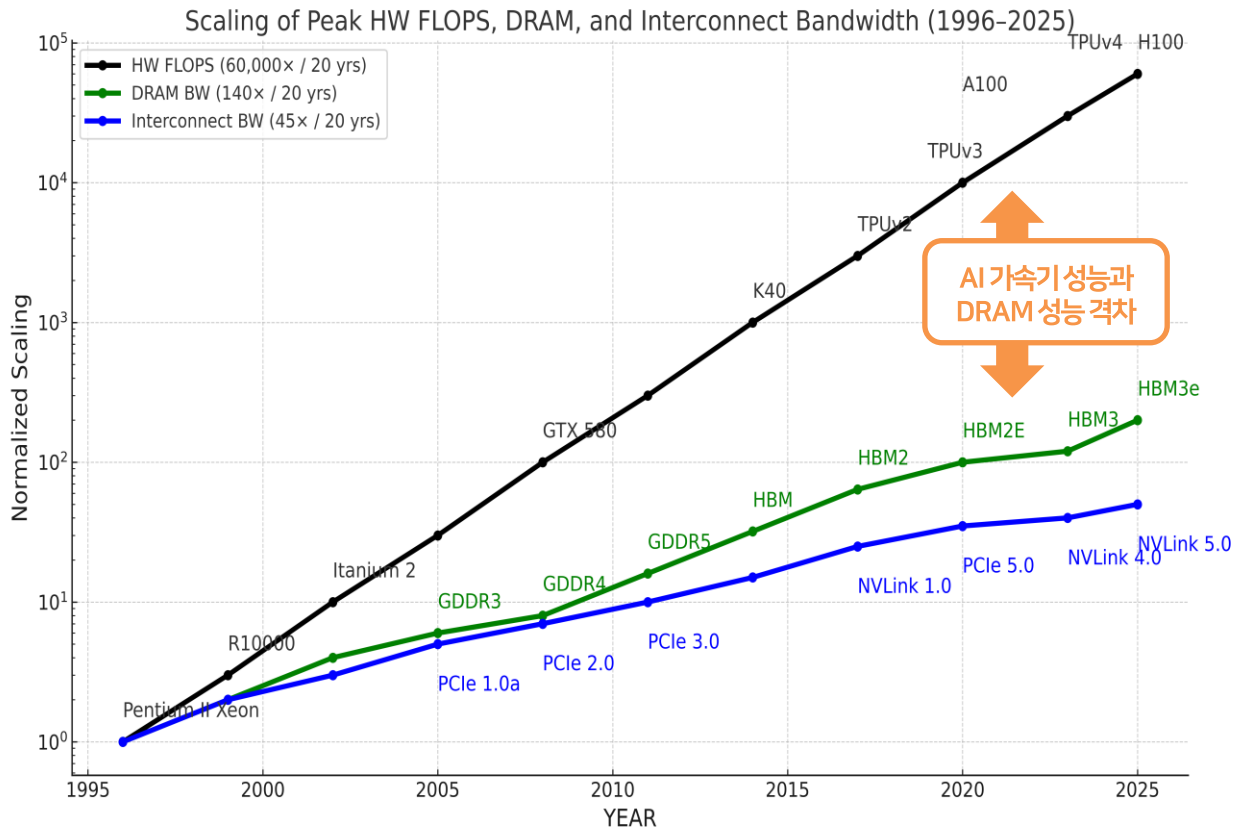
AMD | SYNOPSYS

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~ 現 The Six Semiconductor CTO
'14~'18 Synopsys PHY Digital Design Engineer
'03~'14 AMD PHY Analog Design Engineer 등

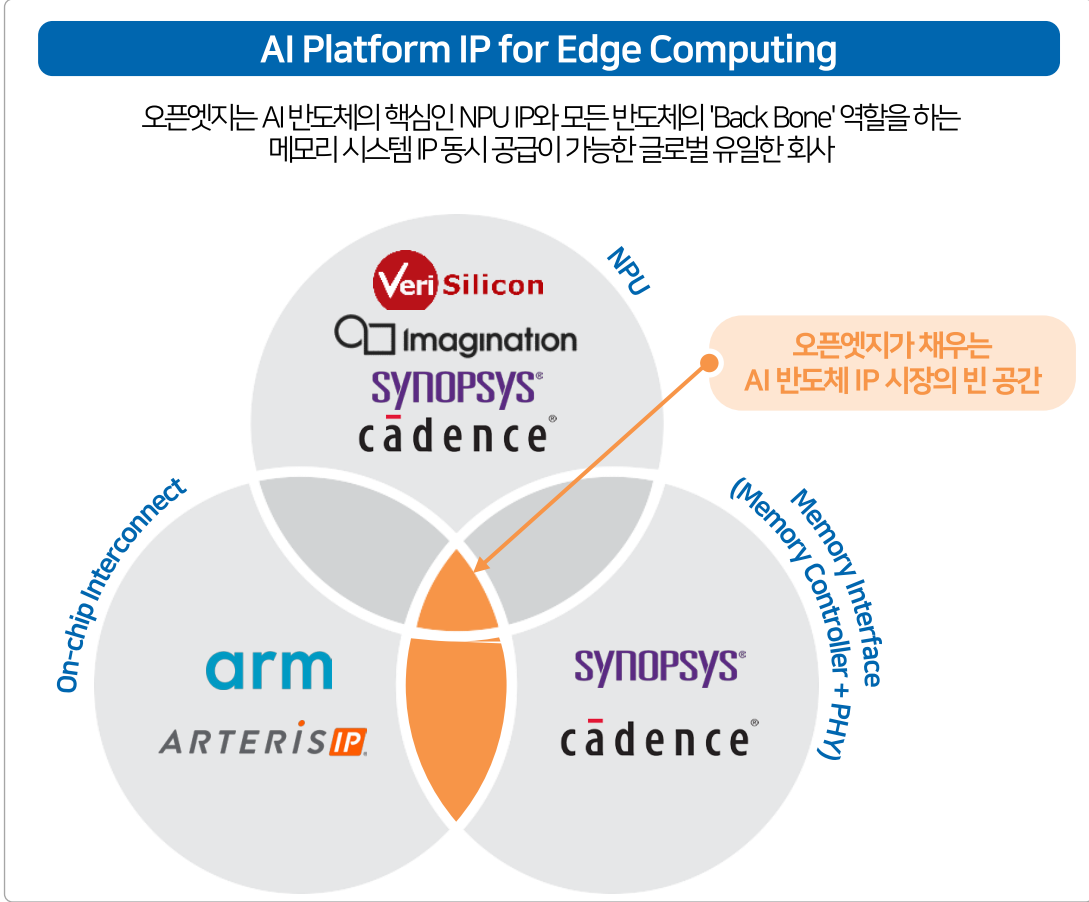
03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ①

AI 반도체는 'Data Intensive Computing' → 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리 시스템 최적화가 필수
 오픈엣지는 글로벌 유일 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 가능 업체

AI 가속기 기술 발전에 따라 Data 처리 요구량과
 DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대



AI 가속기 성능과
 DRAM 성능 격차



※ 출처: AI And Memory Wall By Riselab, nvidia.com, JEDEC.org, PCISIG.com 등

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ②

당사는 수요가 급증하는 On-Device용 IP 개발에 R&D 역량을 집중 중

 : 최근 2년간 Memory Subsystem 제품군 내 개발 대상

구분	IP	Description	개발현황	Remark
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	ENLIGHT™-v1.0 (0.25 ~ 2 TOPS)	Now	경량 IoT 응용제품(키워드 인식, 보안카메라 급 응용)
		ENLIGHT™-v2.0 (2 ~ 16 TOPS)	Now	중급 이상 IoT 응용제품(자율주행 보조 급 응용)
		ENLIGHT™-v2.1	개발 중 (~'26년 1H)	Image Enhancement support
		ENLIGHT™-v3.0 (16 ~ 250 TOPS)	Now	차량용 고성능 응용제품(레벨3급 이상 자율주행 차량 응용)
		ENLIGHT™-v3.1	개발 중 (~'26년 1H)	Language Model (sLM 등)
Total Memory System Solution IP (ORBIT™)	OMC™ (DDR Memory Controller)	HBM3	Now	서버 및 초고성능 제품 향
		DDR5	Now	현재 Mainstream 기술
		GDDR6	Now	고성능 AI 제품 향
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	현재 Mainstream 기술
		LPDDR6/5X	Now	차세대 Mainstream 기술
	OPHY™ (DDR PHY)	LPDDR4X/4	Now	TSMC 22nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4(up to 8.5Gbps)	Now	TSMC 6nm, 7nm, 12nm, 16nm 공정용
		GDDR6	Now	TSMC 12nm 공정용
		HBM3	Now	TSMC 6nm, 7nm 공정용
		LPDDR6/5X	개발 예정	TSMC 4nm 이하 공정용
		LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 8nm, 14nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4(up to 9.6Gbps)	Now	Samsung 5nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X(up to 8.5Gbps)	개발 중 (~'26. 1H)	Samsung 8nm 공정용
		LPDDR5X(up to 10.7Gbps)	개발 중 (~'26. 2H)	Samsung 4nm 공정용
		LPDDR6(up to 14.4Gbps)	개발 중 (~'26. 2H)	Samsung 4nm 공정용
OIC™ (On-Chip-Interconnect)	OIC™	Now	Non-Cache-Coherent NoC	
Chiplet	D2D Chiplet Controller	UCIe 2.0 Controller	개발 중 (~'26.2H)	
	UCIe PHY	UCIe 2.0 PHY	개발 중 (~'27.1H)	TSMC 6/7nm 공정용

저전력/저면적 중심 Edge용 NPU 개발 중

On-Device용 LPDDR IP 개발에 R&D 자원을 집중

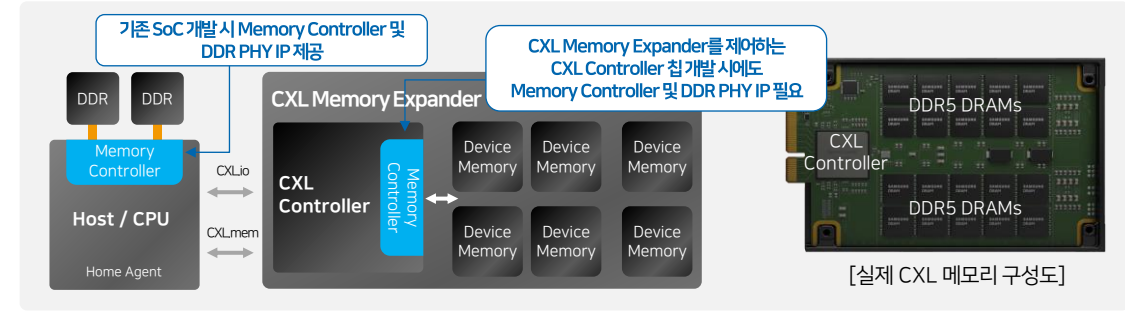
03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ④

국내 Top-tier 메모리사 등과의 협업을 통해 미래 유망기술에 대한 사전 준비도 병행 중

CXL
(Compute Express Link)

글로벌 Top-tier Memory사들과 협업 중

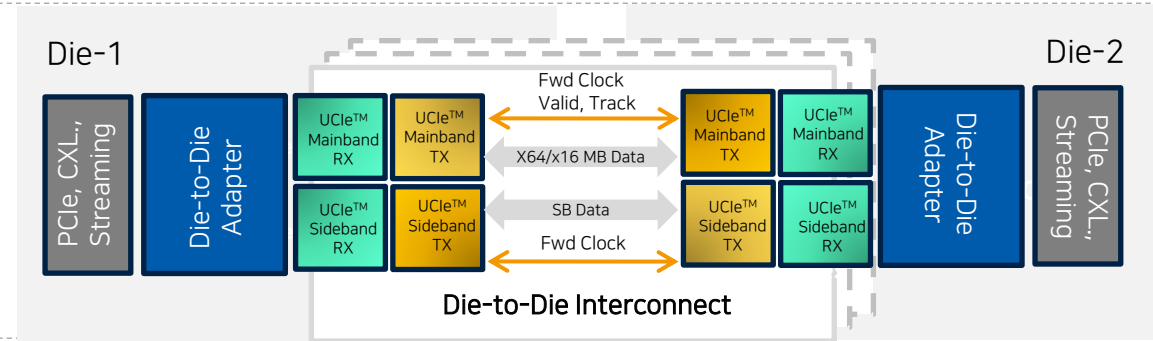
- CXL interface는 기존의 Host/CPU에 종속적인 메모리 표준 용량 및 성능에 대한 제한 없이, 유연하게 메모리를 확장 가능 → AI 반도체와 같은 **Data Intensive 고성능 연산 효과적 지원**
- 오픈엣지는 CXL Memory Expander의 핵심인 **CXL Controller 칩 설계용 IP를 공급**



UCle
(Universal Chiplet Interconnect Express)

UCle Controller 개발 완료 + UCle PHY 개발 중 (~'27.1H)

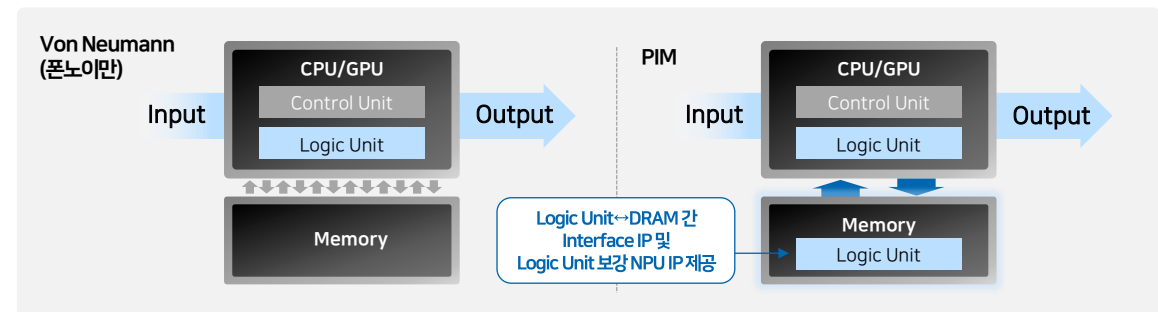
- Chiplet 기술은 하나의 큰 반도체 칩을 여러 개의 작은 기능 단위로 나누어 제조하는 기술로, 미세화가 한계에 다다르면서 UCle(Chiplet 인터페이스 표준)를 통해 작은 칩 여러 개를 조합
- 오픈엣지는 UCle Cont'r를 기 개발 + '27년 중 UCle PHY도 출시 예정
→ **기존 Memory System IP와 Integration을 통한 IP portfolio 확대 및 경쟁력 확보**



PIM
(Process-in-Memory)

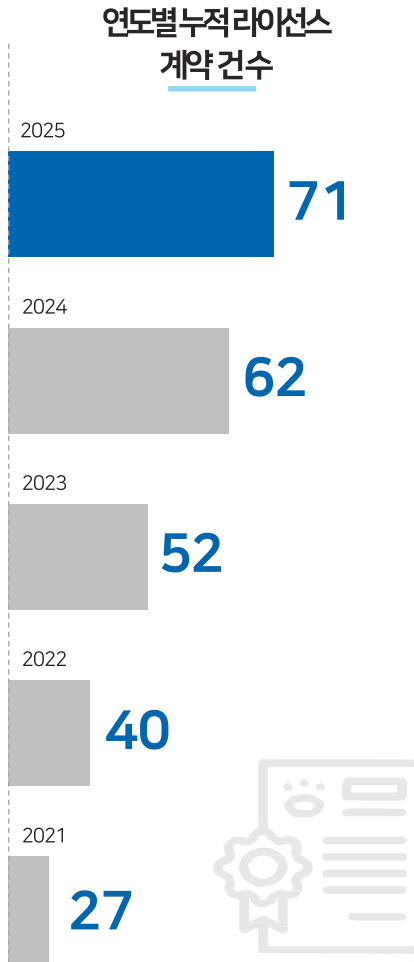
글로벌 Top-tier Memory사와 LP6-PIM 공동연구 진행 중

- PIM은 Host/CPU에서 담당(폰노이만 구조)하는 연산기능의 일부를 off-loading하여 PIM에서 처리 → **연산/저장기능 동시 수행으로 속도 ↑ + 전력소모 ↓**
- 오픈엣지는 PIM 반도체 내 Logic Unit과 DRAM 간 **Data Interface를 담당할 Memory System IP와, Logic Unit의 성능 향상에 필요한 NPU IP를 공급 가능**



04 | 검증된 글로벌 Track Record

다양한 산업의 필수 솔루션으로 가치를 인정받아 글로벌 Track Record 확대 중



지능형 보안카메라

VISIONEXT nextchip
eyenix PnpNetwork Technologies, Inc.

자율주행 / 차량 내 얼굴인식

AISIN Telechips
nextchip GAONCHIPS

서버 / 저장장치

SAMSUNG SK hynix GLENFLY
글로벌/社 asicland novachips

IoT / 모바일

JLQ TECHNOLOGY MONTAGE Technology
SENSCOMM GCT

AI

Micron VeriSilicon
SEMI FIVE DEEPIX

기타 (산업용, 카메라 등)

LX Semicon EYU
RENESAS MegaChips

05 | 글로벌 기업과의 전략적 Partnership

시스템반도체 생태계 내 기업들과 긴밀한 협업을 통한 안정적 IP 수요 확보

Top tier 고객사 Reference 확보



파운드리 협력관계 강화



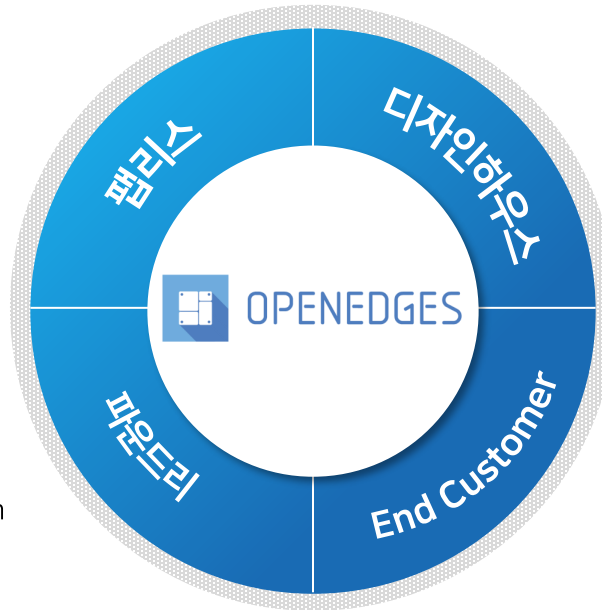
- 양산 실적 확보시 TSMC IP Alliance Program 정식 파트너로 편입될 예정(OIP*)



- 2018년 SAFE** IP 파트너 선정
- 메모리 인터페이스 분야 IP 협력 확대 중

* 주1) OIP (Open Innovation Platform)

** 주2) SAFE (Samsung Advanced Foundry Ecosystem)



Turn-key 수주 디자인하우스와의 전략적 협업



Set 기업의 자체 ASIC SoC 개발 수요 대응



03

2026년 Investment Highlights

AI for Everyone, Everywhere



01 | 2026 Investment Highlights

2026년은 다양한 내외부 모멘텀을 기반으로 사업 수익성 본격 개선 예상



+ 적극적인 비용 효율성 제고

2026년 사업 수익성 본격 개선 전망

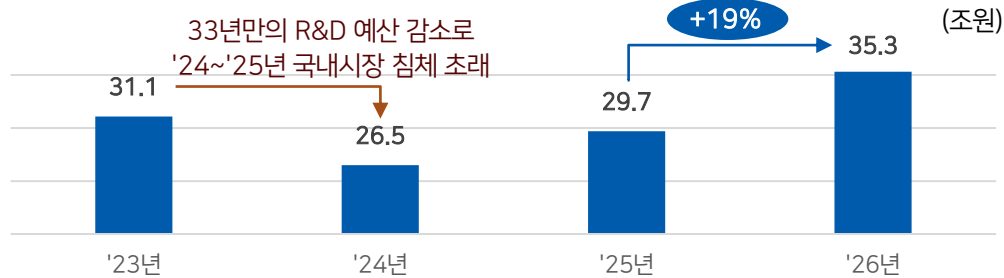
02 | 한국 K-온디바이스 반도체 육성 정책 수혜

오픈엣지는 K-On Device 사업을 포함한 정부 정책지원 확대의 대표 수혜기업

한국 정부의 시스템반도체 산업 육성을 위한 정책 지원 급증

- '26년 R&D 예산은 전년 대비 19% 증가된 역대 최대규모 편성
- 자동차, 로봇, 산업기기 등 On-Device용 시스템반도체 개발 지원 확대

< 연도별 한국 R&D 예산 현황 >



- 국민성장펀드의 산업 생태계 내 유입을 통한 추가적인 시장 활성화 기대
- 총 150조원 규모 중 AI 30조원, 반도체 20조원 지원 예정
- '26년은 과거 2개년 대비 신규 과제 급증으로 IP 라이선스 기회 증가



- 오픈엣지는 'K-On Device AI 반도체 기술개발 사업*'의 대표 수혜기업으로, 사업기획 단계부터 참여 기업들과 적극적인 협업 진행 중
- * 산업부 주관 자동차·방산·IoT/가전·로봇 4개 분야 반도체 개발 지원사업(총 1조원)으로, 수요처가 특정되지 않은 팹리스를 지원하는 것이 아닌, 수요기업(Set 기업)이 사용할 반도체 개발 지원

당사가 집중한 Edge용 NPU 및 LPDDR용 Memory Subsystem IP에 대한 상업 라이선스 수주 및 과제 참여 예상

< K-On Device Project 사업분야 >



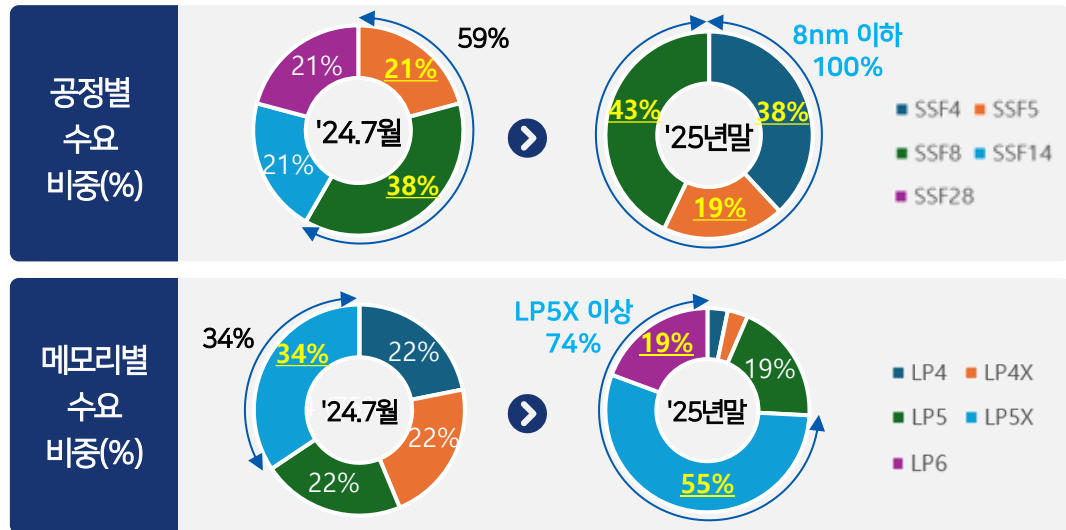
03 | 삼성 파운드리 실적 개선 수혜

삼성 파운드리의 실적 개선에 따른 당사의 라이선스 기회도 증가할 전망

삼성 파운드리 첨단 공정 향 고객사 증가 추세

- 최근 팹리스의 공급망 다변화 기조 하 고객사의 삼성 파운드리 검토 경향 확대
 - TSMC : 가격 인상 및 Capa 부족으로 인한 공급 안정성 감소
 - 삼성 파운드리 : 4·5·8나노 등 공정 등에서 수율 안정화
- 최근 삼성 8나노 이하 첨단 공정에서의 LPDDR5X 이상 최신 기술 수요 급증

< 오픈엠티 수주후보 Pool 내 삼성 파운드리 공정/메모리표준별 비중 변화 >



* 당사는 TSMC 향 IP도 동시 개발/판매 중이나, 아직 TSMC OIP (Open Innovation Platform)는 미편입

- 국내외 삼성 파운드리 디자인하우스와의 전략적 협업 강화
 - ▶ 디자인하우스의 Turn-key 수주에 따른 간접적 수주 기회도 적극 활용

국내		해외	
SEMI FIVE	GAONCHIPS	중국/대만	일본
ADTechnology	CoAsia	VeriSilicon	MegaChips
Alphachips		FARADAY	socionext
		JoinSilicon	

- 삼성 파운드리 8nm 이하 공정에서 높은 전송속도가 구현된 차별화된 제품 판매 확대
 - ▶ 높은 대역폭을 요구하는 Edge Device용 고성능 칩 개발수요에 적극 대응

< 경쟁사 대비 삼성 파운드리 공정별 DDR PHY 전송속도 비교 >

파운드리	공정/메모리Type	오픈엠티	S社	C社	당사 경쟁력	
SAMSUNG Foundry	4nm	LP6	14.4Gbps ('26.2H)	-	14.4Gbps	동등
		LP5X	10.7Gbps ('26.2H)	8.5Gbps	-	우위
	5nm	LP5X	8.5Gbps 출시	8.5Gbps	LP6 개발중 ('27.1Q 목표)	우위
			9.6Gbps ('26.1H)			우위
	8nm	LP5X	9.6Gbps ('26.1H)	8.5Gbps	-	우위

* 출처 : 업계 자료

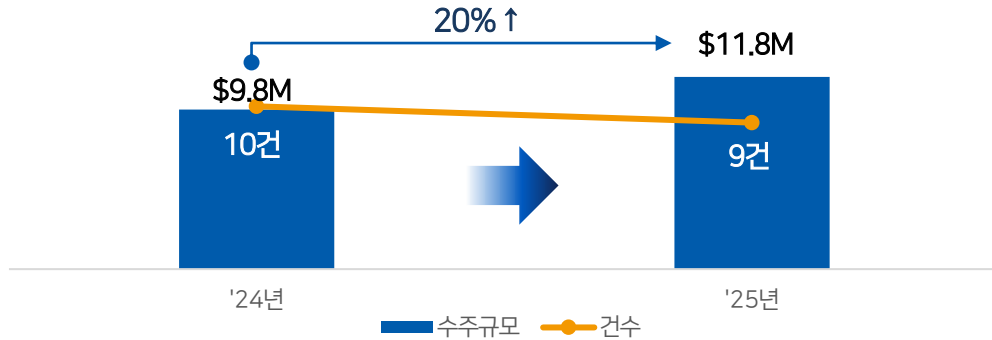
04 | 해외시장에서의 안정적 성장

한국의 시스템반도체 시장점유율은 2% 미만 → 해외 시장에서의 수주확대를 통한 안정적 성장 기반 구축

* Source: Gartner('25.5월)

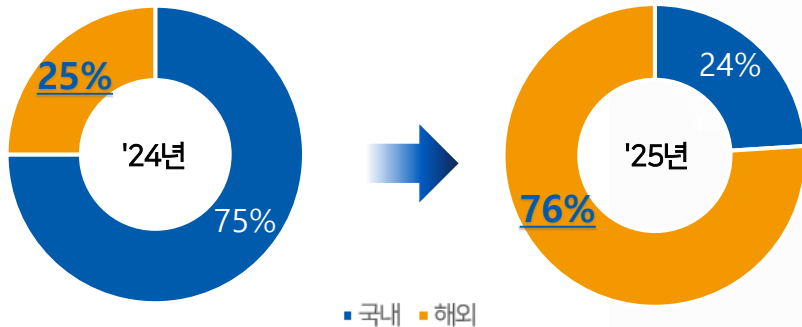
'25년은 국내 시장 부진을 해외 시장에서 만회

- '25년은 전년 대비 20% 성장한 12M\$ 규모 수주



- 해외 고객사 수주규모 증가로 순성장 기록 : (해외 비중) '24년 25% → '25년 76%

* End Customer 기준



- 중국, 일본 등 아시아 국가 중심 안정적 수주 확대 기조 유지 전망



China

- 미·중 무역갈등에 따른 불확실성이 고조됐으나, 최근 단계적 해소로 프로젝트 재개 추세
 - '25.1월 미국 BIS Regulation 발표 후 다수 팹리스들이 프로젝트 중단 혹은 연기
 - 최근 불확실성 점차 완화 추세 : (수주 건수) '25.1H 0건 → '25.2H 3건
- 최근 파운드리 및 IP 다변화를 모색하는데 따른 기회 증가
 - 미국/대만 기술 의존도가 높는데 따른 Risk 관리 차원 변화



Japan

- '25년 신규 확보한 Renesas, Megachips 향 Track Record 적극 활용 중
 - Top-tier Track Record를 통해 보수적인 일본 고객사를 효과적으로 공략 가능
- 전통적으로 TSMC 중심 활용했으나, 최근 SF도 검토 확대 추세
 - 카메라, 가전, 차량용 등 반도체 설계 수요 지속
 - 기존 TSMC 첨단공정 중심 검토했으나, 최근 삼성 8nm 이하 공정 검토 점차 증가

05 | 대형 전략 거래선과의 협업

오픈엣지는 AI 반도체의 구동의 핵심 요소인 'NPU + Memory Subsystem' IP를 제공하는 국내 유일 기업으로, 자체 칩 도입을 검토 중인 국내 대형 기업과의 협업 기회가 확대

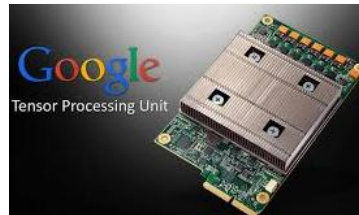
Set 기업들의 자체 칩 개발 Trend 강화

- 글로벌 대형 Set 기업들의 자체 칩 개발 사례 증가
 - 자사 목적에 맞는 칩 성능 최적화, BoM 비용 절감 및 공급망 리스크 감소 등 목적
 - 특히, AI, 모바일, 자율주행 등 분야에서 확대 추세

< 글로벌 Set/서비스 기업의 자체 칩 개발 사례 >



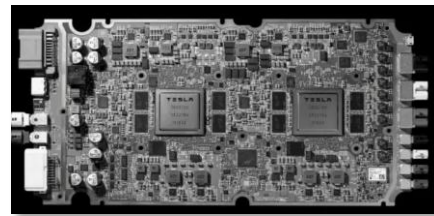
Apple : A, M-Series



Google : TPU



Amazon : Inferentia, Tranium



Tesla : FSD chip

- 국내 대형 기업들의 자체 칩 도입 검토도 증가 추세
 - ▶ IP 기업은 핵심 기술 파트너로서, 자체 칩 도입을 추진하는 Set 기업과 다양한 범위에서 협업이 가능

Set 기업이 Fabless와 협업 시 제약사항

- Fabless는 범용 칩 기반의 다수 고객 대상 개발
- 개별 Set 기업 요구에 대한 최적화에 제약
- 고객별 제품 전략과 로드맵 간 정합성 이슈 발생 가능

Set 기업이 반도체 IP 기업과 협업 시 적합성

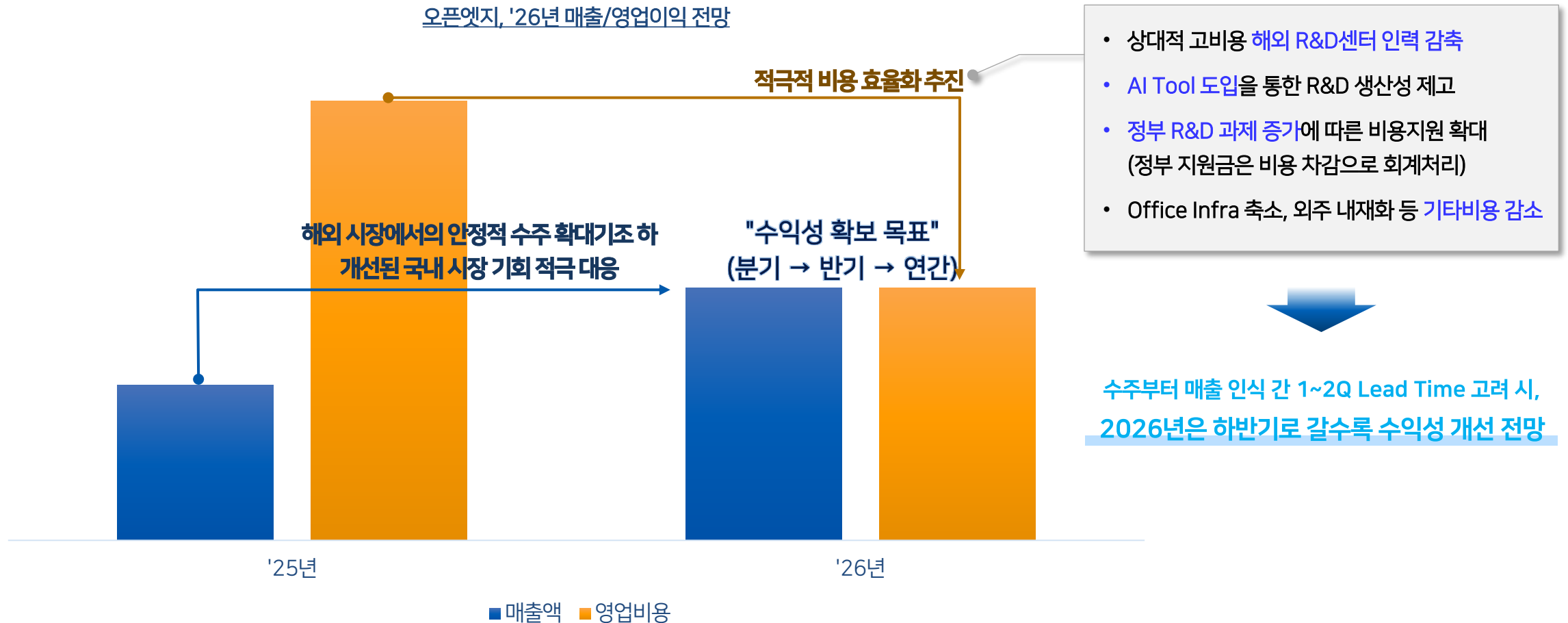
- 칩 판매 주체가 아닌 기술 제공자 포지션
- 고객 아키텍처 및 제품 전략과 이해 상충 최소화
- 기능 단위 선택적 도입 및 맞춤형 설계 지원 가능



06 | 적극적인 비용 효율성 제고를 통한 수익성 개선

기존에는 제품 포트폴리오 확대 기초 하에 공격적으로 R&D 자원을 투입해 왔으나, 중단기적으로 회사 운영기조를 성장 중심에서 수익성 중심으로 전환

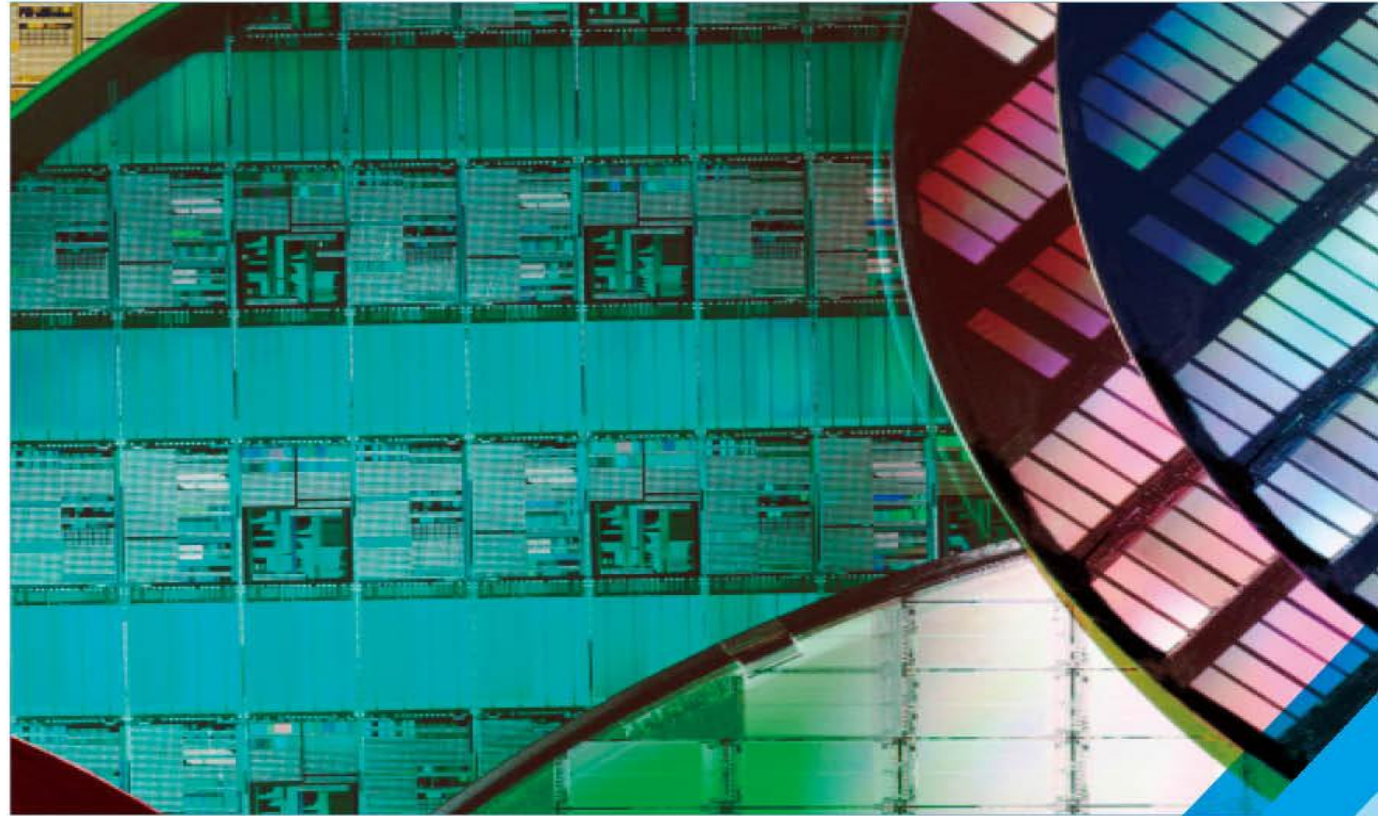
오픈엣지, '26년 매출/영업이익 전망



04

2025년 연간 경영실적

01. 매출
02. 영업이익
03. 세부 매출분석
04. 수주 현황



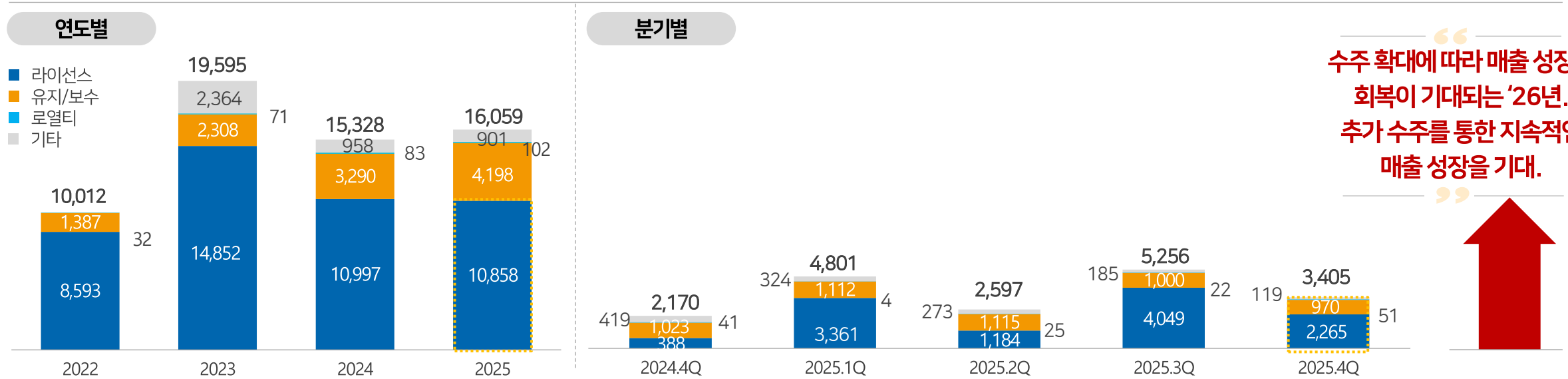
01 | 매출

'25년 연간 매출 160.6억 달성, 전년 대비 5%(YoY) 증가

'26년 매출은 다양한 모멘텀에 따른 수주 증가를 통해 매출 증대 예상

● 매출 현황

(단위: 백만원)



수주 확대에 따라 매출 성장세 회복이 기대되는 '26년. 추가 수주를 통한 지속적인 매출 성장을 기대.



매출 변동요인

- 라이선스**
- 유지보수**
- 로열티**
- 기타**

라이선스 확보된 수주의 IP 제공이 순차적으로 이루어지며 매출 인식 진행됨, '26년에도 기 확보된 수주 및 신규 수주를 통한 매출 성장을 기대

유지보수 늘어나는 수주로 인해 자연스럽게 유지보수 건수와 매출규모도 성장 중에 있음

로열티 고객사의 칩 판매량에 따라 발생 중이며, 고객사의 양산 일정이 순차적으로 도래하며 로열티 매출도 우상향 할 것으로 예상됨

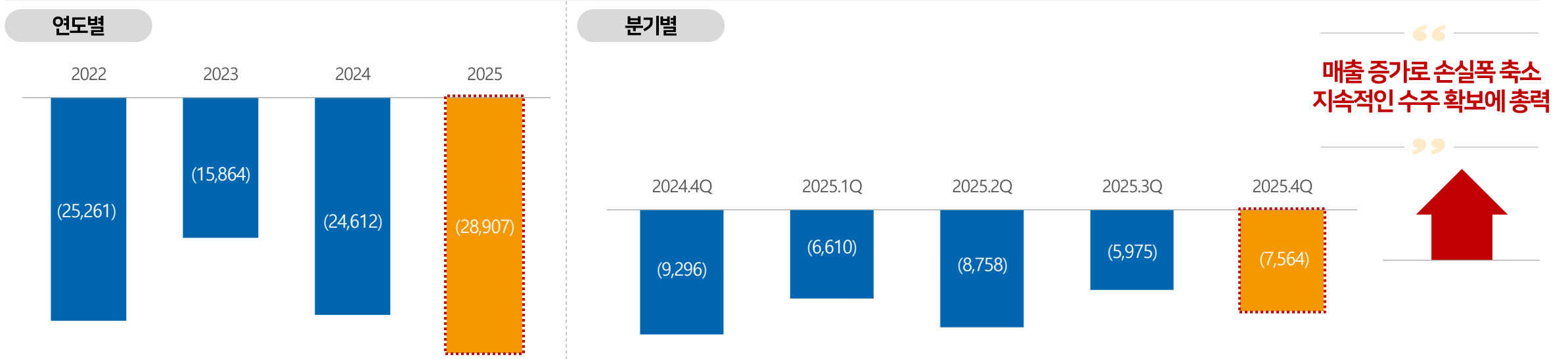
기타 오픈엣지스퀘어향 운영 및 기술 지원 서비스에 대한 매출로 분기당 비슷한 금액으로 매출 인식 중

02 | 영업이익

'25년 4분기 해외 자회사 인력 감축에 따른 비용 반영 '26년은 매출 개선 및 비용 축소에 따른 개선된 수익성 예상

● 영업이익 현황

(단위: 백만원)



영업이익 변동요인

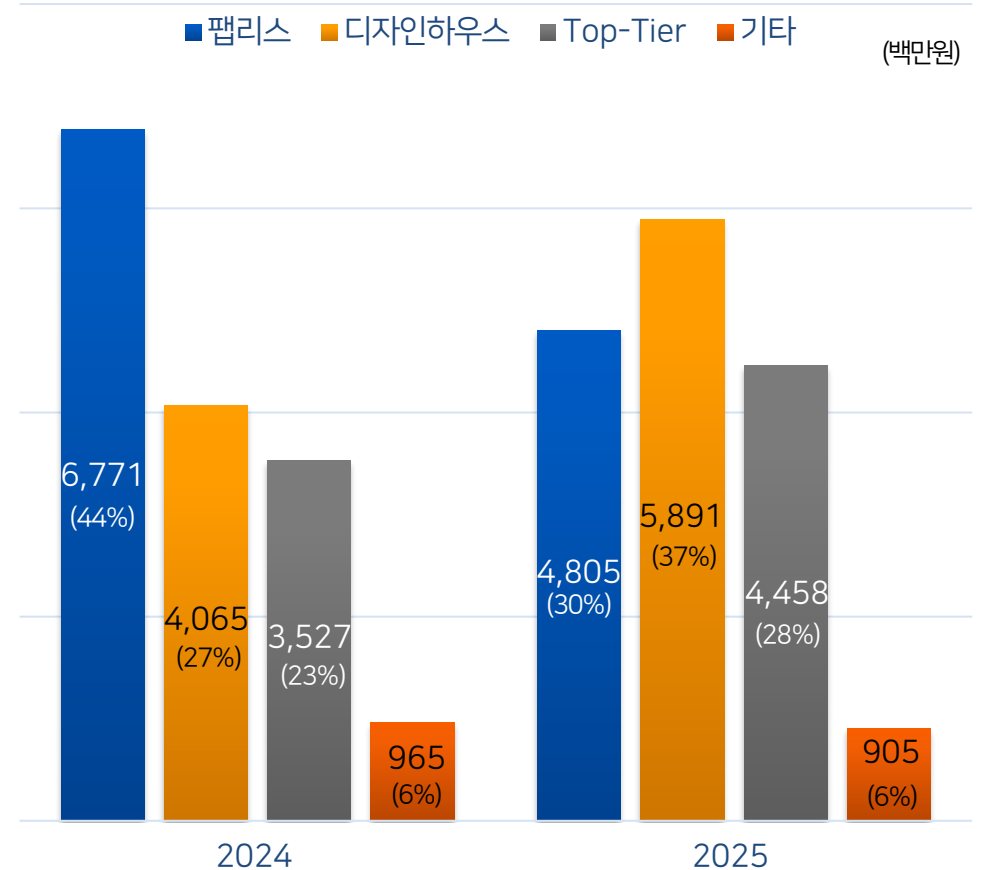
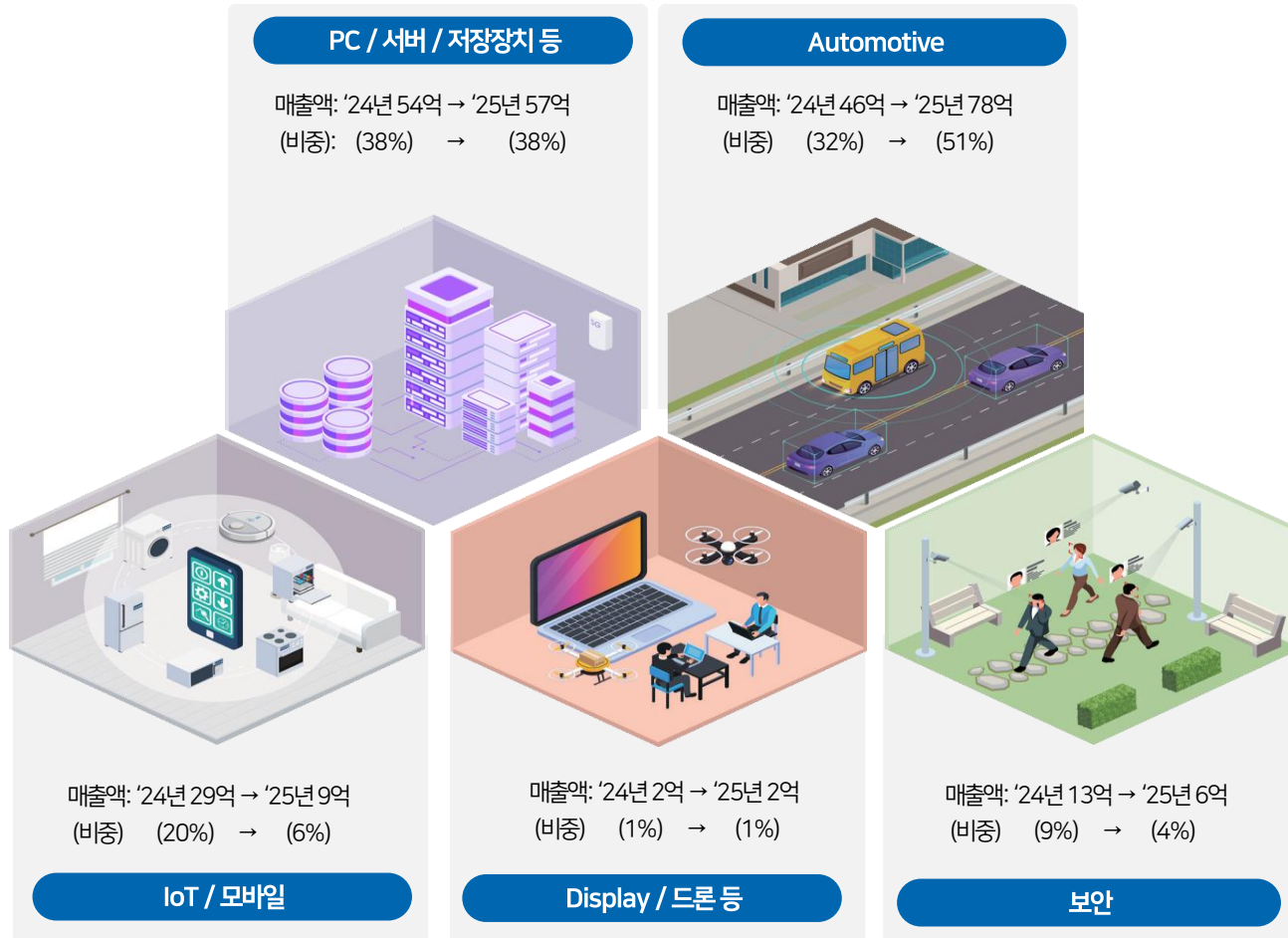
- ✓ IP제공에 따른 매출 증대로 손실폭이 큰 폭으로 감소, 비용은 큰 변화없이 예정된 계획아래 집행 중에 있음
- ✓ 특별한 이벤트 없이 계획된 범위내에서 비용 집행 중이며 신규 IP 개발로 인한 R&D 비용에 주로 활용 중
- ✓ 지속적인 수주 확보를 통한 매출 증대와 함께 수익성 개선을 기대 중이며, 빠른 수주 확보를 위한 Sales 역량 강화에 총력

03 | 세부 매출분석 - ① Application/고객사별

Server 및 Automotive향 비중 확대, Top-tier Chip Maker 중심 고객 구조 안정화

• [Application별] Server 및 Automotive 등을 중심으로 다양한 산업군 향 매출 발생

• [고객사별] 생태계내 다양한 고객사 향 고른 매출 분포



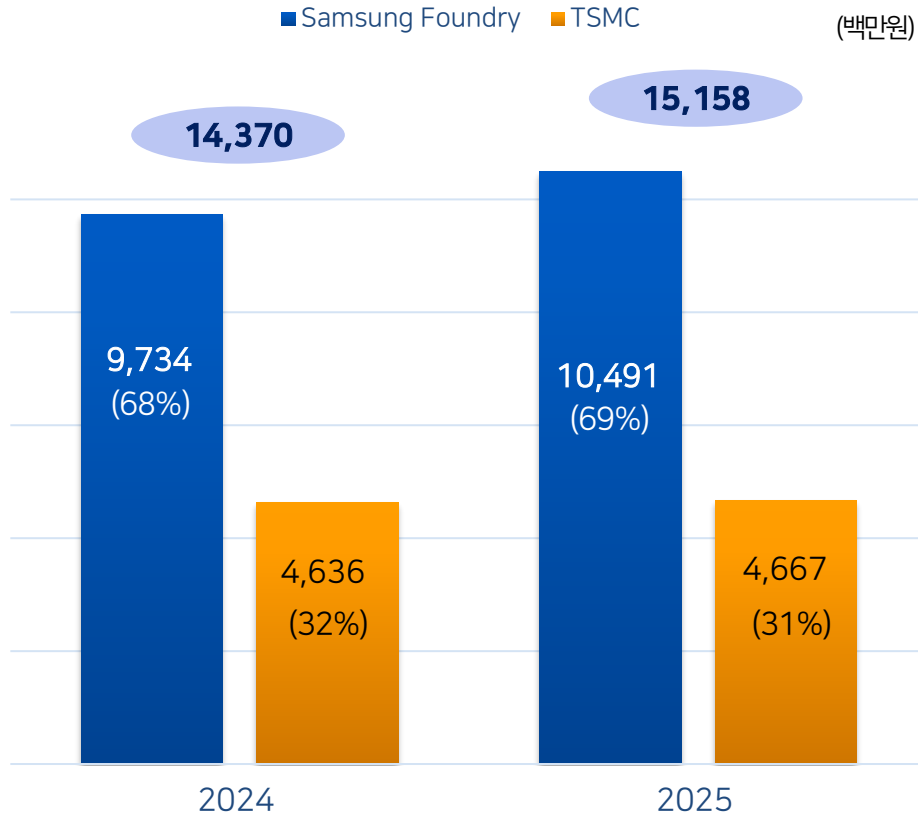
* 기타매출 : 기타고객사+ 오픈엣지스퀘어 향 운영 및 기술 지원 서비스 매출

* 기타매출(기타고객사+ 오픈엣지스퀘어 향 운영 및 기술 지원 서비스 매출) 제외 기준

03 | 세부 매출분석 - ② 파운드리별(당사 IP가 탑재된 고객사 SoC의 생산처)

삼성파운드리 향 70%, TSMC 향 30% 매출 구조 유지

● 파운드리별 매출(당사 IP가 탑재된 SoC의 생산처 기준)



※ 기타매출 및 로열티 제외 기준

오픈엣지 매출의 파운드리별 구분

- 삼성 파운드리 : 4nm 대상 LP6 등 첨단 IP 판매 확대에 따른 비중 확대 전망
 - '26년 국내 수요 증가에 따라 매출규모 확대될 전망
- TSMC : 6/7nm 및 12/16nm용 LP5X 중심 수요 대응 중
 - 고객사 양산 사례 증가에 따른 TSMC OIP 편입 가능여부 지속 타진 중

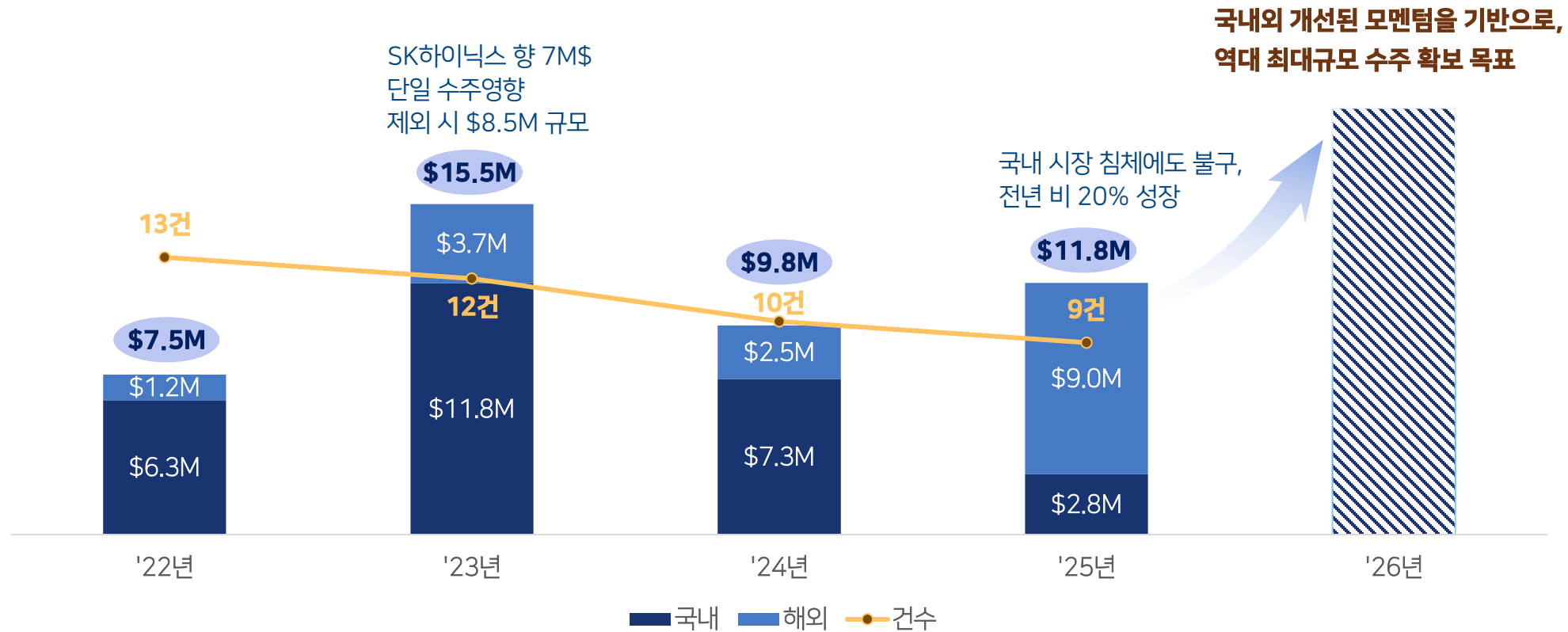
'23~'25년 오픈엣지 파운드리별 매출 현황 (백만원)

	'23년	'24년	'25년	YoY	YoY(%)
S사	10,908	9,734	10,491	757	8%
(%)	(63%)	(68%)	(69%)	(+1%p)	
T사	6,323	4,636	4,667	31	1%
(%)	(37%)	(32%)	(31%)	(-1%p)	
합 계	17,231	14,370	15,158	-	-

04 | 수주현황

'25년은 해외 시장에서의 안정적 수주 확대를 통해 \$11.8M 규모 라이선스 계약 수주를 기록
'26년은 역대 최대규모 수주 확보를 목표

오픈엣지, 수주금액 및 건수 추이



Thank you.

[Appendix] | 요약연결재무제표

● 요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)

	2025	2024	2023	2022
유동자산	30,138	73,965	29,843	44,304
비유동자산	17,407	12,713	14,849	9,552
자산총계	47,545	86,678	44,692	53,855
유동부채	24,851	21,526	19,750	18,318
비유동부채	5,625	4,435	4,371	3,288
부채총계	30,476	25,961	24,121	21,606
자본금	2,501	2,482	2,146	2,116
자본잉여금	167,201	164,313	98,259	96,376
기타자본항목	142	4,633	3,577	2,026
이익잉여금	-152,774	-110,711	-83,412	-68,269
자본총계	17,069	60,717	20,571	32,249

● 요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

	2025	2024	증감	증감(%)
영업수익	16,059	15,328	730	4.76%
영업비용	44,966	39,941	5,025	12.58%
R&D 비용	37,045	30,900	6,144	19.88%
기타영업비용	7,921	9,040	-1,119	-12.38%
영업이익	-28,907	-24,612	-4,295	-17.45%
기타수익	278	206	72	34.95%
기타비용	51	496	-445	-89.74%
금융수익	3,358	2,565	793	30.91%
금융비용	4,073	4,486	-413	-9.20%
세전이익	-29,395	-26,822	-2,573	-9.59%
법인세비용	738	465	273	58.71%
당기순이익	-30,133	-27,287	-2,845	-10.43%

[Appendix] | Financial Summary

Financial Summary

(단위: 백만원)

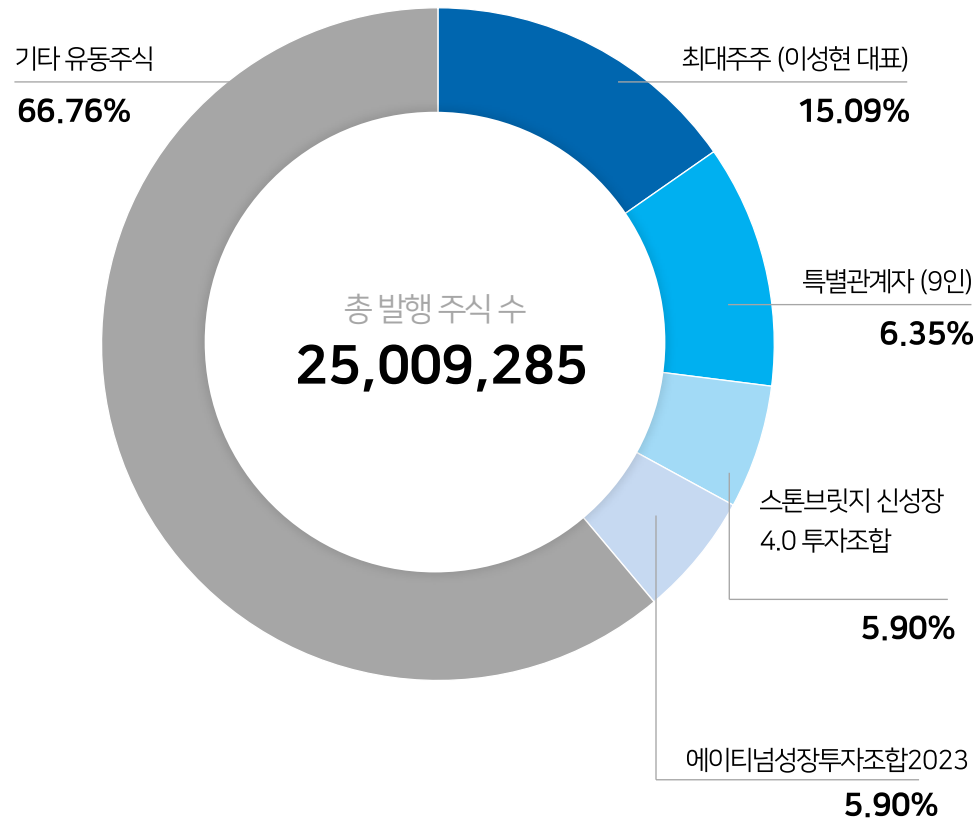
연결재무제표	2020	2021	2022	2023	2024				연간	2025				연간
					1Q24	2Q24	3Q24	4Q24		1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	
매출	1,089	5,186	10,012	19,595	2,484	4,050	6,624	2,170	15,328	4,801	2,597	5,256	3,405	16,059
라이선스	660	4,342	8,593	14,852	1,627	3,103	5,579	688	10,997	3,361	1,184	4,049	2,266	10,859
유지보수	423	808	1,387	2,308	716	764	786	1,023	3,290	1,112	1,116	1,000	970	4,198
로열티	6	35	32	71	2	18	22	41	83	4	25	22	51	102
기타매출	-	-	-	2,363	138	166	237	419	958	324	273	185	118	900
비용	9,581	16,241	35,273	35,458	9,589	9,784	9,101	11,466	39,941	11,411	11,355	11,231	10,969	44,966
R&D 비용	6,159	10,654	27,710	27,184	7,543	7,816	7,095	8,446	30,900	8,828	9,026	8,903	10,288	37,045
기타영업비용	3,422	5,587	7,563	8,275	2,046	1,968	2,006	3,020	9,041	2,583	2,330	2,328	681	7,921
영업이익	△8,492	△11,055	△25,261	△15,864	△7,106	△5,733	△2,477	△9,296	△24,612	△6,610	△8,758	△5,975	△7,564	△28,907
법인세차감전이익	△19,034	△14,524	△24,846	△14,510	△7,106	△5,762	△2,757	△11,198	△26,822	△6,367	△8,887	△5,621	△8,521	△29,395
당기순이익	△19,271	△14,608	△25,227	△14,856	△7,106	△5,762	△2,739	△11,680	△27,287	△6,367	△8,889	△5,637	△9,240	△30,133

※ 연결재무제표 기준

[Appendix] | 주주 현황

최대 주주 (이성현 대표) 지분을 15.09%, 특별 관계자 (9인) 합산 시 21.44%
* Co-founders, 임원 등
스톤브릿지와 에이티넘이 각각 5.90%씩 지분 보유 중

주주 현황 (기준일: '25.12.31.)



Name	Type	# of shares	%
최대주주 (이성현 대표)	보통주	3,774,833	15.09%
특별관계자 (9인)	보통주	1,587,330	6.35%
스톤브릿지 신성장4.0투자조합	CPS	1,474,853	5.90%
에이티넘성장투자조합2023	CPS	1,474,853	5.90%
기타 유동주식	보통주	16,697,416	66.76%
Total		25,009,285	100.00%

※ 참조: '24.7.22 제3차배정유상증자를 통해 스톤브릿지와에이티넘이 각각 전환우선주 1,474,853주씩을 취득함

※ 기준일: '25.12.31.

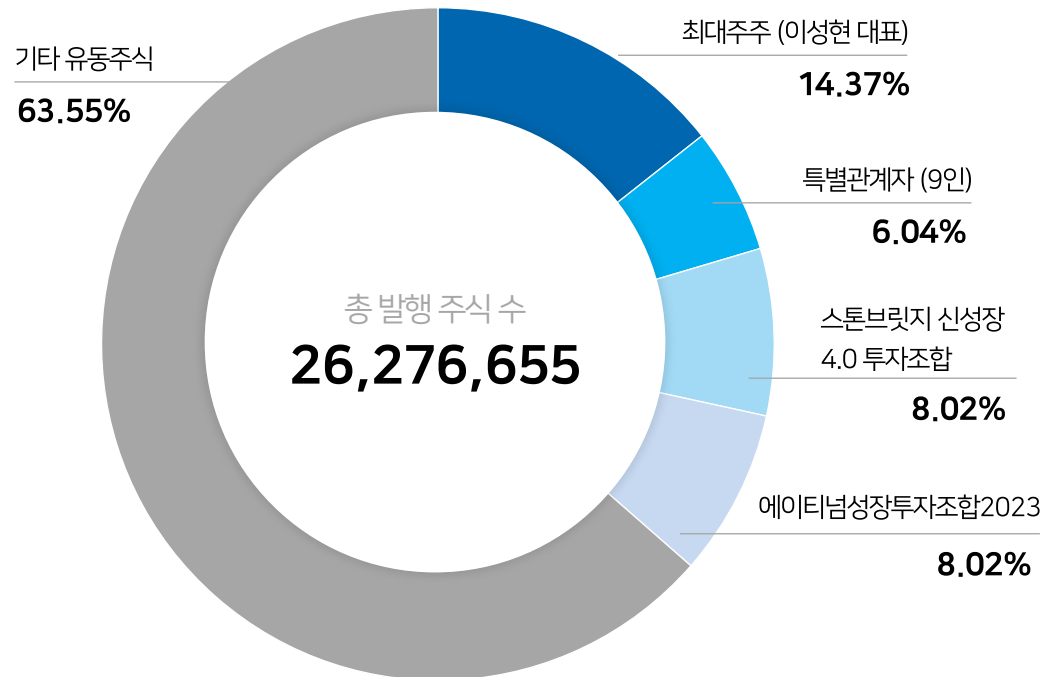
[Appendix] | 주주 현황

최대 주주 (이성현 대표) 지분율 14.37%, 특별 관계자 (9인) 합산 시 20.41%

* Co-founders, 임원 등

스톤브릿지와 에이티넘이 각각 8.02%씩 지분 보유 중

주주 현황 (기준일: '26.1.19.)



Name	Type	# of shares	%
최대주주 (이성현 대표)	보통주	3,774,833	14.37%
특별관계자 (9인)	보통주	1,587,330	6.04%
스톤브릿지 신성장4.0투자조합	보통주	2,106,888	8.02%
에이티넘성장투자조합2023	보통주	2,106,888	8.02%
기타 유동주식	보통주	16,700,716	63.55%
Total		26,276,655	100.00%

※ 참조: '24.7.22 제3차배정유상증자를 통해 스톤브릿지와에이티넘이 각각 전환우선주 1,474,853주씩을 취득하였으며, '26.1.19 상기 전환우선주는 전환가격 조정 (20,341원/주 → 14,239원/주) 후 전량 보통주 각 2,106,888주로 전환되었습니다.

※ 기준일: '26.1.19.